

200mmウェーハ対応大面積ステッパ・リソグラフィ・システム 「UX7-3Di LFS 200」

—2.5D積層パッケージング向け大面積インターポーザ製造に最適—

2.5Dおよび3D積層パッケージング向けの世界有数のリソグラフィ装置メーカーとして、ウシオグループは、世界の半導体市場において、ますます高度化・多様化する要求に応じてきました。

UX7-3Di LFS 200/300 仕様

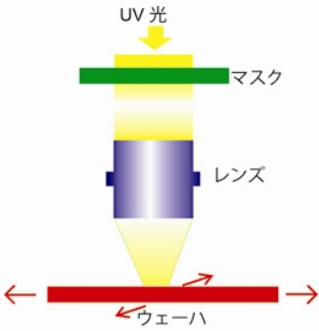
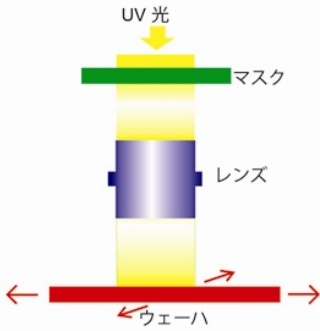
解像度：	2.0 μ m L/S 以下
露光波長：	365 nm
重ね合わせ精度：	表面 500 nm、裏面 500 nm
スループット：	200 mm ウェーハ 115 wph (LFS 200) 300 mm ウェーハ 112 wph (LFS 300)
ウェーハサイズ：	100 mm、150 mm、200 mm (LFS 200)、および 300 mm (LFS 300) に対応
ウェーハ搬送方式：	UX7-3Di プラットフォーム上で自動ウェーハ搬送

UX7-3Di LFS 200/300 特長

- 大面積ショットサイズ 50 x 50 mm (LFS 200) 又は 70 x 70 mm (LFS 300)
- 500 nm 以下の高重ね合わせ精度
- Si を透過する赤外線アライメント機能を搭載し、Si インターポーザに不可欠な TSV (Si 貫通電極) のプロセスに要求される裏面アライメントが可能
- 従来のウェーハレベルパッケージング向けステッパと比較して CoO を 30%向上



UX7-3Di LFS 200: 200 mm ウェーハ対応大面積ステッパ・リソグラフィ・システム

	従来のステッパ	UX7-3Di 大面積投影露光ステッパ
ショットサイズ (mm)	スキャナの2倍	50 x 50 mm/70 x 70 mm
35 mm を超えるサイズのダイ インターポーザ製造能力	無し	有り
スループット (wph)	110 (200 mm ウェーハ)	115 (200-mm) / 112 (300-mm ウェーハ)
大面積ダイインターポーザの スループット	理論値の 60%	理論値の80% から 90%
重ね合わせ精度 (nm)	300	500
解像度 (μm)	1.5 から 2.5	2.0
	 <p>UV 光</p> <p>マスク</p> <p>レンズ</p> <p>ウェーハ</p> <p>ショットエリアが小さいため、 ウェーハ1枚あたりの処理時間 が長い。</p>	 <p>UV 光</p> <p>マスク</p> <p>レンズ</p> <p>ウェーハ</p> <p>ショットエリアが大きいため、 ウェーハ1枚あたりの処理時間 が短い。</p>

従来のステッパと UX7-3Di LFS シリーズの性能比較

USHIOが誇る独自設計の精密投影レンズ

UX7-3Di LFS シリーズには、USHIOが独自に開発した最大 300mm 口径の精密投影レンズが搭載されています。

